

2015年1月吉日

## 第16回半導体パッケージング技術展出展のご案内

テラプローブは、2015年1月14日(水)～16日(金)に東京ビッグサイトで開催される第16回半導体パッケージング技術展に出展いたします。

当社は、ウエハテスト、WLP(Wafer Level Package)、ファイナルテスト、テープ&リールを一貫して提供するターンキーサービス、組込みシステム向け顔認証ソフトウェア・ライブラリ「TeraFaces™」についてご紹介いたします。また、当社ブースでは、ロボットを用いた顔認証デモンストレーションを実施いたします。

是非ご来場賜りますようお願い申し上げます。

### ■ 第16回半導体パッケージング技術展 開催概要

1. 期間 2015年1月14日(水)～16日(金)
2. 時間 10:00～18:00 [16日(金)のみ 17:00 終了]
3. 場所 東京ビッグサイト 東展示棟
4. ブース 東5ホール 東42-50

### ● 本件に関するお問い合わせ先

[sales@teraprobe.com](mailto:sales@teraprobe.com)

電話: 045-476-1002